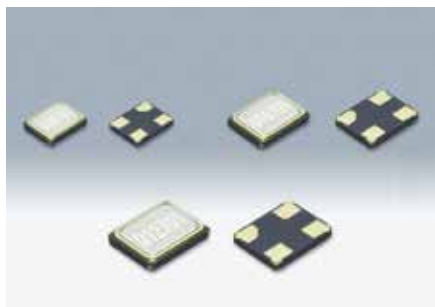


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器

DSX211S/DSX211SH/DSX221SH/DSX321SH (工业设备用)



实际尺寸 DSX211S/SH □ DSX221SH □
DSX321SH □

■ 优点

- 小型·薄型·SMD晶体谐振器 DSX211SH:2016尺寸、厚度0.45mm
DSX221SH:2520尺寸、厚度0.45mm
DSX321SH:3225尺寸、厚度0.65mm
- 耐热性卓越,高精度、高可靠性
- 支持广泛的频率 DSX211S:24MHz~50MHz、80MHz、96MHz
DSX211SH:24MHz~50MHz
DSX221SH:12MHz~54MHz
DSX321SH:12MHz~50MHz
- 依据AEC-Q200 (DSX211S:80MHz、96MHz除外)
- 支持工业设备使用 (频率温度特性: $\pm 50 \times 10^{-6} / -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$)



■ 用途

- 工业设备
- 通信机、近距离无线模块、DVC、DSC、PC等小型设备
- 多媒体设备等车载用途 (依据AEC-Q200)

■ 一般规格

项目	DSX211S				DSX221SH				DSX321SH		
	DSX211SH										
频率范围	24~30MHz	30~50MHz	80MHz	96MHz	12~16MHz	16~24MHz	24~30MHz	30~54MHz	12~20MHz	20~28MHz	28~50MHz
谐波次数	Fundamental										
负载电容	8pF, 10pF, 12pF										
激励电平	10μW (100μW max.)		10μW (200μW max.)								
频率公差	$\pm 20 \times 10^{-6}$ (at 25°C)										
串联电阻	100Ω max.	80Ω max.	30Ω max.	200Ω max.	150Ω max.	100Ω max.	60Ω max.	80Ω max.	60Ω max.	50Ω max.	
频率温度特性	$\pm 50 \times 10^{-6} / -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$ (Ref. to 25°C)										
保存温度范围	-40~+105°C										
包装单位 (1)	3000pcs./reel (φ 180)										

(1) 无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ DSX211S/SH [mm]

■ DSX221SH [mm]

■ DSX321SH [mm]

[mm]

■ 外形尺寸

■ 内部连接 (Top View)

#1、3为晶体端子
#2、4与防护罩连接
#2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考) (Top View)

■ 外形尺寸

■ 内部连接 (Top View)

#1、3为晶体端子
#2、4与防护罩连接
#2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考) (Top View)

■ 外形尺寸

■ 内部连接 (Top View)

#1、3为晶体端子
#2、4与防护罩连接
#2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考) (Top View)